

判決年月日	平成 2 3 年 1 2 月 2 2 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成23年（行ケ）第10149号		

○名称を「非接触 I D 識別装置用の巻線型コイルと I C チップとの接続構造及びこれを構成する接続方法」とする発明に係る特許の無効審判において、訂正を認めた上で発明の進歩性を認め、審判請求を不成立とした審決について、訂正を認めた判断に誤りはないが、銅製の巻線型コイルに接続される I C チップの接続端子の最外層を構成する金層の厚さを 1 0 ～ 1 5 μ m とすることや、金膜と巻線型コイルとの熱圧着について全率固溶体が形成されるようにすることは、当業者が容易に想到することができたものであるとして、審決を取り消した事例

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項

「非接触 I D 識別装置用の巻線型コイルと I C チップとの接続構造及びこれを構成する接続方法」に関する発明に係る特許について、原告が無効審判請求をしたところ、特許庁は、審判請求は成り立たないとの審決をしたが、原告が同審決の取消しを求めた審決取消訴訟（平成 2 1 年（行ケ第 1 0 2 9 5 号）において、知財高裁は、進歩性にかかる審決の判断は誤りであるとして、これを取り消した。本件は、この取消しにより再開された無効審判において、特許庁が被告の訂正請求を認めた上、発明の進歩性を認め、再度、審判請求は成り立たないとの審決をしたため、原告が同審決の取消しを求めた事案である。

審決は、主引用例と本件特許発明とを対比して、相違点(ア)ないし(エ)を認定し、相違点(ア)、(ウ)及び(エ)は格別のものとはいえないと判断したが、相違点(イ)については、接続端子の最外層の金膜を 1 0 ～ 1 5 μ m とすることにより、これに加えることが可能な加圧力により良好に塑性流動し、金膜と導線の銅との相互拡散により全率固溶体の生成が良好になるところ、請求人（原告）は金膜の厚さと全率固溶体の生成の間にこのような関係があることが技術常識であることを示す証拠を提出していないとして、当業者が容易に想到し得るものということとはできないと判断した。

原告は、取消事由として、本件訂正を認めた判断の誤り、相違点(イ)に係る判断の誤りなどを主張した。

本判決は、本件訂正を認めた審決の判断に誤りはないが、銅製の巻線型コイルに接続される I Cチップの接続端子の最外層を構成する金属の厚さを $10 \sim 15 \mu\text{m}$ とすることは、本件特許出願当時、適宜想到することができた事項であり、また、厚さを $10 \sim 15 \mu\text{m}$ 程度とした金膜と巻線型コイルとの熱圧着について、全率固溶体が形成されるようにすることも、当業者において容易に想到することができたものであり、相違点(イ)に係る審決の判断は誤りであるとして、審決を取り消した。